

## Gældende lov.

## Lovforslaget.

ning) eller ved filmkredsteknik er dannet elektriske ledere, kontakter eller andre trykte komponenter (f. eks. induktions-spoler, modstande og kondensatorer), anbragt enkeltvis eller forbundet efter et forud bestemt mønster, med undtagelse af komponenter, der kan producere, ensrette, modulere eller forstærke et elektrisk signal (f. eks. halvlederkomponenter).

Betegnelsen trykte kredsløb omfatter ikke kredsløb i forbindelse med komponenter, som ikke er fremstillet ved trykkeprocessen. Trykte kredsløb kan dog være forsynet med ikke-trykte forbindelsesdele.

Tynd- eller tykfilmkredsløb indeholdende passive og aktive elementer, der er fremstillet under samme tekniske proces, henføres under pos. 85.21.

5. A. Ved dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter i pos. 85.21 forstås komponenter, hvis funktion er afhængig af forandringer i modstanden under indvirkning af et elektrisk felt.

B. Ved elektroniske mikrokredsløb i pos. 85.21 forstås:

a. Kredsløbsblokke af typerne „fagot“-moduler, støbte moduler, mikromoduler etc., bestående af diskrete, aktive eller både aktive og passive miniaturekomponenter, som er kombineret og indbyrdes forbundet.

b. Integrerede monolitiske kredsløb, hvori kredsløbselementerne (dioder, transistorer, modstande, kondensatorer, forbindelsesledninger etc.) hovedsagelig er fremstillet i massen og på overfladen af et halvledermateriale (f. eks. doteret silicium) og udgør en uadskillelig enhed.

c. Integrerede hybride kredsløb, hvori passive og aktive elementer — nogle fremstillet ved tynd- eller tykfilmteknik (modstande, kondensatorer, forbindelsesledninger etc.) og andre fremstillet ved halvlederteknik (dioder, transistorer, integrerede monolitiske kredsløb etc.)